

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 6 月 23 日 (23.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/056674 A1

(51) 国際特許分類⁷: C08L 33/00, C08K 5/00, H01B 3/00

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/018628

(22) 国際出願日: 2004 年 12 月 14 日 (14.12.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2003-416158
2003 年 12 月 15 日 (15.12.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): TDK
株式会社 (TDK CORPORATION) [JP/JP]; 〒1038272
東京都中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 佐藤 茂樹
(SATO, Shigeki) [JP/JP]; 〒1038272 東京都中央区日
本橋一丁目 1 3 番 1 号 TDK 株式会社内 Tokyo (JP).
野村 武史 (NOMURA, Takeshi) [JP/JP]; 〒1038272 東
京都中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号 TDK 株式
社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 大石 皓一 (OISHI, Koichi); 〒1010063 東京都
千代田区神田淡路町一丁目 4 番 1 号 友泉淡路町ビ
ル 8 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護
が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA,
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,
BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,
BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,
IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: DIELECTRIC PASTE FOR SPACER LAYER OF MULTILAYER CERAMIC ELECTRONIC COMPONENT

(54) 発明の名称: 積層セラミック電子部品のスペーサ層用の誘電体ペースト

(57) Abstract: Disclosed is a dielectric paste for spacer layers of multilayer ceramic electronic components which does not dissolve a binder contained in a layer adjoining to a spacer layer in a multilayer ceramic electronic component and thus is capable of effectively preventing occurrence of defects in the multilayer ceramic electronic component. The dielectric paste for spacer layers contains an acrylic resin as a binder, and also contains at least one solvent selected from the group consisting of limonene, α -terpinyl acetate, I-dihydrocarvyl acetate, I-menthone, I-perillyl acetate, I-carvyl acetate and d-dihydrocarvyl acetate.

(57) 要約: 本発明は、積層セラミック電子部品のスペーサ層に隣接する層に含まれているバインダを溶解することがなく、積層セラミック電子部品に不具合が発生することを効果的に防止することができる積層セラミック電子部品のスペーサ層用の誘電体ペーストを提供することを目的とする。本発明にかかるスペーサ層用の誘電体ペーストは、アクリル系樹脂をバインダとして含み、リモネン、 α -ターピニルアセテート、I-ジヒドロカルビルアセテート、I-メントン、I-ペリリルアセテート、I-カルビルアセテートおよびd-ジヒドロカルビルアセテートよりなる群から選ばれる少なくとも一種の溶剤を含んでいる。

WO 2005/056674 A1